

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司\*

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0981)

### 中芯截至二零零七年九月三十日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（[中芯]或[本公司]）於今日公佈截至二零零七年九月三十日止三個月的綜合經營業績。二零零七年第三季的銷售額與二零零七年第二季相比上升4.4%至391,400,000元，與二零零六年第三季度相比上升6.1%。毛利率由二零零七年第二季的10.3%升至二零零七年第三季的10.8%。二零零七年第三季的淨虧損為25,600,000元由於記憶晶圓市場價格嚴重下滑，二零零七年第二季的淨虧損為2,100,000元。每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為0.069元。
- 以下為本公司於二零零七年十月三十日就截至二零零七年九月三十日止三個月的未經審核業績在報章所作的報章公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條規定的披露責任於二零零七年十月三十日作出本公佈。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海一二零零七年十月三十日，國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零七年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

#### 二零零七年第三季概要

- 二零零七年第三季的銷售額與二零零七年第二季相比上升4.4%至391,400,000元，與二零零六年第三季度相比上升6.1%。
- 毛利率由二零零七年第二季的10.3%上升至二零零七年第三季的10.8%。
- 二零零七年第三季的淨虧損為25,600,000元由於記憶晶圓市場價格嚴重下滑，二零零七年第二季淨虧損為2,100,000元。

- 每股美國預托股份淨虧損（攤薄）為 0.069 元

關於本季營運成果，中芯國際總執行長張汝京博士表示：“中芯國際晶圓代工業務在 2007 年第三季持續成長，營收較去年同期及上一季均呈現成長。我們的邏輯業務和其他非 DRAM 業務如期發展，其營收較第二季成長 12.1% 達 299,000,000 美元。來自 90 納米制程的營收比重則由 2007 年第二季之 22.0% 成長為 26.7% 毛利率由 2007 年第二季之 10.3% 略增加為 2007 年第三季之 10.8%，主要系較高之產能利用率及較多之邏輯產品出貨所致。營運方面，晶片出貨較去年同期成長 10.7%，而產能利用率則由 2006 年第三季之 84.3% 成長為 94.1%。

即使在非 DRAM 晶圓代工服務的強勢表現下，我們的業務仍受持續嚴重下滑的 DRAM 市場價格影響。DRAM 營收占整體營收比重自 2007 年第二季之 28.9% 下滑為 23.6% 本季虧損 25,600,000 美元，其中 1000 萬美元之虧損系來自增提 DRAM 備抵存貨跌價損失之金額。我們預期在未來兩季 DRAM 晶圓的營收比重將下降。

為了減少資本支出及增加產能，我們目前正代為管理由地方政府出資及擁有之晶片廠以作為我們長期策略的一部分。其中成都 8 寸廠進展順利。第二季已開始進行試產同時我們預期年底前將開始量產。至於武漢 12 寸廠，我們仍然計劃在 2007 年第四季中開始設備移入。

我們的技術發展藍圖如預期進行，且 65 納米技術研發有穩定的進展。2GB NAND 快閃記憶體已於 2007 年 9 月開始商業生產，而我們亦正進行 8GB NAND 快閃記憶體的開發。

與 Spansion 在策略上簽署合作協定，協定中 Spansion 將轉移其 65 納米快閃記憶體技術予中芯國際。此次合作將使中芯國際得以在特定快閃記憶體市場以 Spansion 專利製造及銷售 90 納米及 65 納米，以及未來可能之 Spansion MirrorBit<sup>®</sup> Quad 之產品。

我們專致於我們的策略，同時有信心為領先客戶群透過在中國地區謹慎的先進制程研發，將可帶予中芯國際長期而堅實的成長。

電話會議 / 網上業績公佈詳情

日期：二零零七年十月三十一日

時間：上海時間上午八時正

撥號及登入密碼：美國 1-617-597-5342（密碼：SMIC）或香港 852-3002-1672（密碼：SMIC）。

二零零七年第三季業績公佈網上直播可於 [www.smics.com](http://www.smics.com) 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

## 關於中芯

中芯國際積體電路製造有限公司（“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981）總部位於中國上海，是世界領先的積體電路晶片代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的積體電路晶片製造企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 90 奈米及更先進的晶片代工服務。中芯國際在上海建有三座 200mm 晶片廠和一座 300mm 晶片廠，該 300mm 晶片廠已開始試投產。北京建有兩座 300mm 晶片廠，在天津建有一座 200mm 晶片廠。中芯國際還在美國、義大利、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯在成都建有封裝測試廠以及有一座代為經營管理的 200mm 晶片廠，在武漢有一座代為經營管理的先進的 300mm 晶片廠。詳細資訊請參考中芯國際網站

<http://www.smics.com>。

## 安全港聲明

（根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案）

本次新聞發佈可能載有（除歷史資料外）依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述包括關於我們預期在未來兩季來自於 DRAM 的銷售收入占總銷售收入的比例將下降，中芯盈利能力成長和改善，以及在隨後“資本開支概要”和“二零零七年第四季度指引”中的聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，儘管並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知風險、不確定性，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，包括（但不限於）與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造生產量供給及最終市場的金融局勢是否穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會（「證交會」）的文件資料，包括其於二零零七年六月二十九日以 20-F 表格形式呈交予證交會的經修訂的年度報告，特別是「風險因素」及「有關財政狀況及經營業績的管理層討論及分析」兩個部份，以及其於二零零四年三月八日以 A-1 表格形式呈交予香港聯合交易所（「香港聯交所」）的登記聲明，以及中芯可能不時向證交會及香港聯交所呈交的該等其他文件，包括 6-K 表格。其他未知或不可預知的因素亦可能會對中芯日後的業績、表現或成就造成重大不利影響。鑒於上述風險、不確定性、假設及因素，本新聞發佈中提及的前瞻性事件可能不會發生。務請閣下注意，切勿過份依賴此等前瞻性陳述，此等陳述僅就本新聞發佈中所載述日期（或如無有關日期，則為本新聞發佈日期）的情況而表述。除法律有所規定以外，中芯概不就因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

## 台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日，台積電於美國加州阿拉米達郡高級法院，指稱本公司違反和解協定、違反本票約定及不當使用商業機密而對本公司及若干子公司（中芯上海、中芯北京及中芯美國）提出訴訟。台積電訴求（其中包括）損害賠償、禁制令、律師費及提前支付和解協定項下尚未支付之金額。

在目前的訴訟中，台積電指稱本公司將台積電之商業機密運用於製造本公司0.13微米或更小制程之產品。台積電進一步稱，由於本公司違約，台積電對本公司的專利授權隨之終止，而有關對於本公司較大工藝產品之不起訴承諾亦已失效。

本公司強烈否認所有不當使用之指控。此外，台積電尚未證明、亦未拿出任何證據證明本公司之任何不當使用行爲。目前，該訴求仍爲未經證明的指控，而爲本公司所否認。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除提出強烈否認台積電在美國訴訟中提出的指控外，本公司已於二零零六年九月十二日在美國反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反默示的誠信及公平交易的承諾，要求台積電作出損害賠償。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司及本公司的全資子公司中芯上海及中芯北京共同提起的針對台積電違反誠實信用原則、商業詆毀的不公平競爭行爲的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司尋求（其中包括）判令台積電停止侵權行爲、公開向本公司道歉和賠償（包括台積電因其侵權行爲所獲得的利潤）。

台積電於二零零七年一月向美國加州法院動議禁止中國訴訟。於二零零七年二月，台積電向北京市高級人民法院提出司法管轄權的異議，質疑北京市高級人民法院對中國訴訟的司法管轄權限。

於二零零七年三月，加州法院駁回台積電有關禁制中國訴訟的動議。台積電就加州法院的判決提出上訴。

於二零零七年七月，北京市高級人民法院駁回台積電對中國訴訟的司法管轄權的異議並認爲北京市高級人民法院擁有適當的司法管轄權審理該訴訟。台積電就北京市高級人民法院的判決，向中華人民共和國最高人民法院提出上訴。

二零零七年八月十四日，本公司修訂對台積電提出的反訴，尋求（其中包括）台積電違約的賠償。

二零零七年八月十五日至十七日，美國加州法院就台積電申請臨時禁制令欲禁止中芯國際製造或分銷特定的0.13um或以下的邏輯技術產品作出聆訊。法院在二零零七年九月七日作出裁定，該裁定拒絕台積電提出的臨時禁制令申請，因而本公司的業務發展及銷售得以不受影

響。另該裁定僅要求本公司若在某些情況下披露其邏輯技術予非中芯的機構時，必須於10天前通知台積電，以讓台積電可就該披露提出反對。

根據美國財務會計準則第144號，本公司須決定該未決訴訟是否構成需要進一步分析專利許可組合是否已受損害之事件。我們相信，該法律訴訟現處於十分早期階段，我們仍在評估訴訟是否屬於該類事件。本公司預期將會獲得進一步資料以協助我們做出決定。根據美國財務會計準則第144號進行之任何損害分析結果可能對本公司財務狀況及經營業績產生重大影響。由於訴訟仍處於早期階段，本公司未能評估頒佈不利判決的可能性或估計潛在虧損的金額或範圍。

投資者聯絡資料：

Theresa Teng	Adam Weng	Phyllis Liu
電話: +86-21-5080-2000 內線: 16278	電話: +86-21-5080-2000 內線: 16275	電話: +86-21-5080-2000 內線: 12315
Theresa_Teng@smics.com	Adam_Weng@smics.com	Phyllis_Liu@smics.com

二零零七年第三季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	季度比較	二零零六年 第三季度 <sup>(3)</sup>	年度比較
銷售收入	391,398	374,829	4.4%	368,926	6.1%
銷售成本	349,148	336,339	3.8%	342,046	2.1%
毛利	42,250	38,490	9.8%	26,880	57.2%
經營開支	62,435	47,113	32.5%	40,317	54.9%
經營虧損	(20,185)	(8,623)	134.1%	(13,437)	50.2%
其他收入（支出），淨額	(4,342)	6,085	-	(21,819)	-80.1%
所得稅利益（支出）	(966)	1,621	-	3,047	-
稅後淨虧損	(25,493)	(917)	2680.0%	(32,209)	-20.9%
少數股權	859	(137)	-	(2,674)	-
應占聯營公司虧損	(919)	(1,001)	-8.2%	(1,097)	-16.2%
淨虧損	(25,553)	(2,054)	1144.1%	(35,980)	-29.0%
毛利率（遞延成本調整前）					
毛利率	10.8%	10.3%		7.3%	
經營利潤率	-5.2%	-2.3%		-3.6%	

每股普通股股份淨虧損—基本(1)	(0.0014)	(0.0001)		(0.0020)	
每股美國預托股份淨虧損—基本	(0.0690)	(0.0056)		(0.0980)	
每股普通股股份淨虧損—攤薄(1)	(0.0014)	(0.0001)		(0.0020)	
每股美國預托股份淨虧損—攤薄	(0.0690)	(0.0056)		(0.0980)	
付運晶圓(8吋等值)(2)	458,466	443,445	3.4%	413,985	10.7%
產能使用率	94.1%	88.9%	—	84.3%	—

附注：

(1) 基於二零零七年第三季加權平均普通股 18,523,000,000 股（基本）及 18,523,000,000 股（攤薄），二零零七年第二季 18,477,000,000 股（基本）及 18,477,000,000 股（攤薄），二零零六年第三季度 18,356,000,000 股（基本）及 18,356,000,000 股（攤薄）。

(2) 包括銅接連件

(3) 重列

- 二零零七年第三季銷售額升至391,400,000元，較二零零七年第二季的374,800,000元錄得季度升幅4.4%，並較二零零六年第三季度的368,900,000元錄得年度升幅6.1%。與二零零七年第二季相比，邏輯晶圓銷售額增加13.0%而記憶晶圓銷售額下降14.6%。
- 銷售成本由二零零七年第二季的336,300,000元上升3.8%至二零零七年第三季的349,100,000元，主要由於記憶晶圓市場價格持續嚴重下滑，以至於截止二零零七年第三季記憶晶圓存貨跌價準備損失增加。
- 二零零七年第三季毛利上升至42,300,000元，較二零零七年第二季的38,500,000元錄得季度升幅9.8%；較二零零六年第三季度的26,900,000元錄得年度升幅57.2%。
- 毛利率從二零零七年第二季的10.3%上升至二零零七年第三季10.8%，主要是由於產能使用率增加以及邏輯產品的出貨比列上升所致。此等改善部分被記憶晶圓價格下滑所抵消。
- 二零零七年第三季的總經營費用由二零零七年第二季的47,100,000元上升至62,400,000元，錄得季度升幅32.5%，主要由於研發費用和一般行政費用增加所致。
- 二零零七年第三季的研發費用增加至25,900,000元，較二零零七年第二季的23,200,000元錄得季度升幅11.7%主要由於上海新建12寸廠的相關費用以及65納米技術的研發費用增加所致。
- 一般行政費用由二零零七年第二季的14,700,000元上升至二零零七年第三季的23,800,000元。排除匯兌損失，一般行政費用持平於18,100,000元。二零零七年第三季源於經營活動的匯兌損失為5,700,000元，相較於二零零七年第二季的匯兌收益4,800,000元。然而，結合來自於非經營性活動的匯兌收益（錄入其他收入），二零零七年第三季的總匯兌收益為2,000,000元，相較於二零零七年第二季的匯兌收益3,300,000元。

- 二零零七年第三季的銷售及市場推廣相關費用上升至4,900,000元，較二零零七年第二季4,200,000元錄得季度升幅15.8%。

## 1. 收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	二零零六年 第三季度
電腦	22.7%	25.2%	33.0%
通訊	50.0%	40.7%	37.1%
消費	18.3%	24.3%	25.2%
其他	9.0%	9.8%	4.7%
以服務類別分類	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	二零零六年 第三季度
邏輯 <sup>(3)</sup>	66.8%	61.8%	65.4%
記憶	23.6%	28.9%	30.1%
管理服務	3.1%	3.2%	0.4%
光罩製造，探測及其它	6.5%	6.1%	4.1%
以客戶類別分類	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	二零零六年 第三季度
非廠房半導體公司	45.5%	43.8%	36.9%
集成裝置製造商	40.0%	42.3%	50.4%
系統公司及其它	14.5%	13.9%	12.7%
以地區分類	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	二零零六年 第三季度
北美洲	44.7%	39.6%	38.6%
亞太區（不包括日本）	26.4%	29.1%	25.4%
日本	10.1%	8.9%	7.5%
歐洲	18.8%	22.4%	28.5%
晶圓收入分析			
各技術占晶圓銷售額的百分比（僅包括邏輯、記憶及銅接連件）	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	二零零六年 第三季度
0.09 微米	26.7%	22.0%	4.9%
0.13 微米	28.6%	33.0%	41.2%
0.15 微米	2.0%	1.2%	7.2%
0.18 微米	28.8%	30.8%	36.1%
0.25 微米	1.0%	0.7%	2.6%
0.35 微米	12.9%	12.3%	8.0%
各邏輯技術占邏輯晶圓銷售額百分比 (1)	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	二零零六年 第三季度
0.09 微米	13.7%	15.3%	4.6%
0.13 微米 (2)	22.7%	19.0%	11.1%
0.15 微米	2.7%	1.9%	11.8%
0.18 微米	41.0%	43.6%	55.3%
0.25 微米	1.4%	0.9%	4.1%
0.35 微米	18.5%	19.3%	13.1%

附注：

- (1) 不包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 代表來自于全流程製造晶圓的銷售收入
- (3) 包括 0.13 微米銅接連件

• 產能：

廠 / (晶圓尺寸)	二零零七年 第三季度*	二零零七年 第二季度*
上海廠 (8 吋) <sup>(1)</sup>	98,000	94,000
北京廠 (12 吋) <sup>(2)</sup>	61,200	54,000
天津廠 (8 吋)	21,000	21,000
每月晶圓裝配總產能	180,200	169,000

附注：

\* 期終每月晶圓計 8 吋等值

- (1) 上海廠現由晶圓一廠、晶圓二廠、晶圓三廠組成。
- (2) 北京廠現由晶圓四廠、晶圓五廠、晶圓六廠組成。

- 截至二零零七年第三季度末，每月產能增加至 180,200 片 8 吋等值晶圓。

付運及使用率：

8 吋等值晶圓	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	二零零六年 第三季度
付運晶圓 (包括銅接連件)	458,466	443,445	413,985
使用率 (1)	94.1%	88.9%	84.3%

附注：

(1) 產能使用率按輸出晶圓總額除以估計產能計算

- 二零零七年第三季晶圓付運增加至 458,466 片 8 吋等值晶圓，較二零零七年第二季的 443,445 片 8 吋等值晶圓及二零零六年第三季度的 413,985 片 8 吋等值晶圓分別錄得季度升幅 3.4% 及年度升幅 10.7%。



## 2. 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	季度比較	二零零六年 第三季度	年度比較
銷售成本	349,148	336,339	3.8%	342,046	2.1%
折舊	151,720	159,154	-4.7%	196,993	-23.0%
其他製造成本	189,069	168,408	12.3%	136,327	38.7%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	-	5,886	-
股權報酬	2,473	2,891	-14.5%	2,840	-12.9%
毛利	42,250	38,490	9.8%	26,880	57.2%
毛利率	10.8%	10.3%	-	7.3%	-

- 銷售成本由二零零七年第二季的336,300,000元上升3.8%至二零零七年第三季的349,100,000元, 主要由於記憶晶圓市場價格持續下滑, 以至於截止二零零七年第三季記憶晶圓存貨跌價準備損失增加。
- 二零零七年第三季毛利上升至42,300,000元, 較二零零七年第二季的38,500,000元錄得季度升幅9.8%; 較二零零六年第三季度的26,900,000元錄得年度升幅57.2%。
- 毛利率從二零零七年第二季的10.3%上升至二零零七年第三季10.8%, 主要是由於產能使用率增加以及邏輯產品的出貨比列上升所致, 此等改善部分被記憶晶圓價格下滑所抵消。

### 經營開支分析

以千美元計	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	季度比較	二零零六年 第三季度	年度比較
總經營開支	62,435	47,113	32.5%	40,317	54.9%
研究及開發	25,906	23,194	11.7%	27,319	-5.2%
一般及行政	23,836	14,746	61.6%	4,216	465.4%
銷售及市場推廣	4,901	4,234	15.8%	3,614	35.6%
無形資產攤銷	7,751	6,213	24.8%	6,040	28.3%
資產處置損失(收入)	41	(1,274)	-	(872)	-

- 二零零七年第三季的總經營費用由二零零七年第二季的47,100,000元上升至62,400,000元, 錄得季度升幅32.5%, 主要由於研發費用和一般行政費用增加所致。
- 二零零七年第三季的研發費用增加至25,900,000元, 較二零零七年第二季的23,200,000元, 錄得季度升幅11.7%主要由於上海新建12寸廠的相關費用以及65納米技術的研發費用增加所致。
- 一般行政費用由二零零七年第二季的14,700,000元上升至二零零七年第三季的23,800,000元。排除匯兌損失, 一般行政費用持平於18,100,000元。二零零七年第三季源於經營活動的匯兌損失為5,700,000元, 相較於二零零七年第二季的匯兌收益

4,800,000 元。然而，結合來自於非經營性活動的匯兌收益（錄入其他收入），二零零七年第三季的總匯兌收益為 2,000,000 元，相較於二零零七年第二季的匯兌收益 3,300,000 元。

- 二零零七年第三季的銷售及市場推廣相關費用上升至 4,900,000 元，較二零零七年第二季 4,200,000 元錄得季度升幅 15.8%。

## 其他收入（支出）

以千美元計	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度	季度比較	二零零六年 第三季度	年度比較
其他收入(支出)	(4,342)	6,085	-	(21,819)	-80.1%
利息收入	2,204	2,679	-17.7%	2,970	-25.8%
利息支出	(14,791)	3,343	-	(12,247)	20.8%
其他，淨額	8,245	63	12987.3%	(12,542)	-

- 二零零七年第三季其他非經營性虧損為 4,300,000 元，相較於二零零七年第二季度的非經營性收益 6,100,000 元，主要是由於二零零七年第二季度收到有關於 12 寸晶圓廠建設的貸款利息政府補貼所致。
- 其他，淨額增加是由於二零零七年第三季來自於非經營性活動的匯兌收益為 7,700,000 元，二零零七年第二季度為匯兌虧損 1,500,000 元。結合來自於經營活動的匯兌虧損，二零零七年第三季的總匯兌收益為 2,000,000 元，二零零七年第二季度的總匯兌收益為 3,300,000 元。

## 流動資金

以千美元計	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度
現金及現金等價物	382,987	372,449
短期投資	69,947	73,080
應收賬款	308,020	300,379
存貨	254,875	237,966
其他	80,614	125,413
流動資產總計	1,096,443	1,109,287
應付賬款	387,356	483,925
短期借款	70,000	108,000
長期借款的即期部份	290,744	290,533
其他	144,326	124,086
流動負債總計	892,426	1,006,544
現金比率	0.4x	0.4x
速動比率	0.9x	0.7x
流動比率	1.2x	1.1x

## 資本結構

以千美元計	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度
現金及現金等價物	382,987	372,449
短期投資	69,947	73,080
長期票據即期部分	29,493	29,242
長期票據	64,996	64,443
短期借款	70,000	108,000
長期借款的即期部份	290,744	290,533
長期借款	587,091	574,564
總借款	947,835	973,097
股東權益	3,007,379	3,027,635
總借款對權益比率	31.5%	32.1%

## 現金流量概要

以千美元計	二零零七年 第三季度	二零零七年 第二季度
來自于經營活動的現金淨額	142,910	152,999
來自于投資活動的現金淨額	(107,751)	(146,800)
來自于融資活動的現金淨額	(24,571)	24,593
現金變動淨額	10,538	30,745

## 資本開支概要

- 二零零七年第三季資本開支為 139,000,000 元。
- 計劃下的二零零七年資本開支總額將約為 700,000,000 元，並將根據市場狀況做調整。

## 二零零七年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已于之前的安全港聲明中闡明。

- 銷售額預期比二零零七年第三季度增加 2%-5%。
- 經營開支相對銷售的百分比預期 15%左右。

- 資本開支預期約介於 60,000,000 元至 90,000,000 元之間。
- 折舊及攤銷預期約介於 185,000,000 元至 205,000,000 元之間。

#### 近期公佈

- 中芯國際 2007 年技術研討會在上海召開 (二零零七年九月二十一日)
- 截止二零零七年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (二零零七年九月二十日)
- 美國法院駁回台積電針對與中芯國際訴訟中提出的臨時禁止令申請 (二零零七年九月九日)
- 中芯國際舉辦 2007 深圳技術研討會 (二零零七年八月三十日)
- 非執行董事之離任及委任 (二零零七年八月三十日)
- Synopsys 攜手中芯國際挺進中國移動電視市場 (二零零七年八月二十九日)
- 奇夢達擴展與中芯國際技術合作協定 (二零零七年八月二十一日)
- Cadence 與中芯國際為無線晶片設計者推出通過驗證的射頻工藝設計工具包 (二零零七年八月二日)
- 中芯國際二零零七年第二季業績報告 (二零零七年七月二十六日)

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

[http://www.smics.com/website/enVersion/Press\\_Center/pressRelease.jsp](http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/pressRelease.jsp)

## 合并資產負債表 (美元)

截至以下日期止

二零零七年九月三十日

二零零七年六月三十日

### 資產

#### 流動資產:

現金及現金等價物	382,987,357	372,449,095
短期投資	69,946,991	73,079,577
應收賬款, 已扣除撥備(二零零七年九月三十日為4,496,016元, 二零零七年六月三十日為4,688,098元)	308,020,158	300,379,234
存貨	254,874,702	237,966,018
預付款項及其它流動資產	27,310,047	13,059,060
廠房、機台及其它固定資產銷售應收款	50,180,365	109,907,931
待售資產	3,123,567	2,445,806

流動資產合計 **1,096,443,187** **1,109,286,721**

土地使用權, 淨額	47,133,249	47,139,822
廠房及設備, 淨額	3,275,509,427	3,375,543,336
購入無形資產, 淨額	72,925,914	62,413,712
遞延成本	76,523,714	82,410,154
股權投資	10,782,486	11,407,056
其他長期預付款	3,179,173	3,551,063
遞延稅資產	34,582,059	33,036,474

資產合計 **4,617,079,209** **4,724,788,338**

### 負債及股東權益

#### 流動負債:

應付帳款	387,356,058	483,925,496
預提費用及其它流動負債	114,781,960	94,683,683
短期借款	70,000,000	108,000,000
長期票據的即期部份	29,492,873	29,242,001
長期借款的即期部份	290,744,282	290,533,471
應付所得稅	51,233	159,421

流動負債合計 **892,426,406** **1,006,544,072**

#### 長期負債:

長期票據	64,995,655	64,442,787
長期借款	587,090,705	574,563,677
與特許權協定相關的長期應付款	26,453,014	14,458,131
遞延稅負債	2,633,174	184,367

長期負債合計 **681,172,548** **653,648,962**

負債合計 **1,573,598,954** **1,660,193,034**

少數股權

36,101,510

36,960,657

股東權益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份為

50,000,000,000 股，截止二零零七年九月三十日

已發行股份為 18,536,981,058 股，未發行的股份

為 18,493,184,050 股。

7,414,793

7,397,274

認股權證

32,387

32,387

額外繳入股本

3,307,574,393

3,302,244,424

累計其他綜合盈餘（虧損）

14,195

64,874

累計虧絀

(307,657,023)

(282,104,312)

**所有股東權益合計**

**3,007,378,745**

**3,027,634,647**

**總負債及股東權益合計**

**4,617,079,209**

**4,724,788,338**

合并營運報表  
(美元)

截至以下日期止三個月  
二零零七年九月三十日                      二零零七年六月三十日

銷售額	391,397,891	374,829,258
銷售成本	349,147,976	336,338,574
<b>毛利</b>	<b>42,249,915</b>	<b>38,490,684</b>
經營費用:		
研究和開發	25,906,095	23,193,707
一般及行政	23,835,922	14,746,510
銷售和市場推廣	4,900,813	4,234,048
購入無形資產攤銷	7,750,931	6,213,171
來自廠房設備和其他固定資產的銷售損失 (所得)	41,576	(1,274,018)
<b>經營費用總額</b>	<b>62,435,337</b>	<b>47,113,418</b>
<b>經營虧損</b>	<b>(20,185,422)</b>	<b>(8,622,734)</b>
其他收入(支出):		
利息收入	2,203,909	2,678,460
利息支出	(14,790,753)	3,343,327
匯兌收益(虧損)	7,722,330	(1,514,169)
其他,淨額	522,314	1,577,151
<b>其他收入(支出),淨額</b>	<b>(4,342,200)</b>	<b>6,084,769</b>
<b>所得稅、少數股權及股權投資前淨虧損</b>	<b>(24,527,622)</b>	<b>(2,537,965)</b>
所得稅利益(費用)	(965,676)	1,621,322
少數股權	859,147	(136,518)
股權投資虧損	(918,560)	(1,001,034)
<b>淨虧損</b>	<b>(25,552,711)</b>	<b>(2,054,195)</b>
每股股份淨虧損,基本	(0.0014)	(0.0001)
每股美國預托股份淨虧損,基本	(0.0690)	(0.0056)
每股股份淨虧損,攤薄	(0.0014)	(0.0001)
每股美國預托股份淨虧損,攤薄	(0.0690)	(0.0056)
用作計算基本每股普通股 虧損淨額的股份	18,523,392,676	18,476,528,957
用作計算攤薄每股普通股收入	18,523,392,676	18,476,528,957

虧損額的股份

\* 遞延股票報酬攤銷乃關於：

銷售成本	2,472,711	2,890,848
研究和開發	880,402	1,274,430
一般管理	427,639	1,291,079
銷售和市場推廣	875,343	549,542



## 合并现金流量表 (美元)

截至以下日期止三個月  
二零零七年九月三十日 二零零七年六月三十日

### 經營活動：

淨虧損	(25,552,711)	(2,054,195)
淨收入至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整：		
少數股權	(859,147)	136,518
處置廠房及設備損失(收益)	41,576	(1,274,018)
折舊及攤銷	176,792,146	175,187,932
購入無形資產攤銷	7,750,931	6,213,171
股票報酬攤銷	4,656,095	6,005,899
長期票據非現金利息費用	1,051,275	1,195,552
股權投資虧損	918,560	1,001,034
<b>營運資產及負債的變動：</b>		
應收賬款，淨額	(7,640,924)	(12,352,703)
存貨	(16,908,684)	(346,549)
預付款及其它流動資產	(7,675,557)	(52,120)
應付賬款	(7,269,481)	(4,132,746)
預提費用及其它流動負債	16,811,333	(14,740,560)
應付所得稅	(108,188)	(46,650)
遞延稅資產	(1,545,585)	(1,679,557)
遞延稅負債	2,448,807	(62,328)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>142,910,446</b>	<b>152,998,680</b>

### 投資活動：

購入廠房及設備	(161,067,992)	(159,994,428)
處置廠房及設備所得款項	53,182,673	7,926,063
出售待售資產所得款項	935,393	2,501,868
購買所獲無形資產	(3,933,399)	(3,984,011)
購買短期投資	(28,807,101)	(15,006,035)
出售短期投資	31,939,688	21,756,260
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(107,750,738)</b>	<b>(146,800,283)</b>

### 融資活動：

短期借款所得款項	17,000,000	105,000,000
長期借款所得款項	12,737,840	-
償還長期票據支付的款項	-	(15,000,000)
償還長期借款支付的款項	-	(25,438,892)
償還短期借款支付的款項	(55,000,000)	(40,000,000)
行使雇員購股權所得款項	691,393	1,031,855

回購可贖回優先股	-	(1,000,000)
<b>融資活動所用（所耗）現金淨額</b>	<b>(24,570,767)</b>	<b>24,592,963</b>
匯率變動的影響	(50,679)	(46,154)
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>10,538,262</b>	<b>30,745,206</b>
<b>現金及現金等價物一期間開始</b>	<b>372,449,095</b>	<b>341,703,889</b>
<b>現金及現金等價物一期間結束</b>	<b>382,987,357</b>	<b>372,449,095</b>

於本公佈刊發日期，本公司董事分別有董事會主席兼獨立非執行董事王陽元先生、本公司總裁、首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事汪正綱先生、以及本公司獨立非執行董事徐大麟先生、川西剛先生、蕭崇河先生、陳立武先生、虞有澄先生及江上舟先生。

承董事會命  
**中芯國際集成電路製造有限公司**  
 首席執行官  
**張汝京**

中國上海，二零零七年十月三十日  
 \* 僅供識別